

# 华虹半导体有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A26 版)  
4、本次发行前已经制定或实施的股权激励计划限售安排

发行人不存在本次发行前制定并准备在上市后实施的 A 股股权激励计划,不适用 A 股市场关于股票限售的相关规定。

(十四)股票登记机构  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十五)上市联席保荐人  
国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准,公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

根据《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》(国办发〔2018〕21 号)及《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》(中国证券监督管理委员会公告〔2020〕26 号)规定“已境外上市红筹企业的市值要求为符合下列标准之一:(一)市值不低于 2,000 亿元人民币;(二)市值 200 亿元人民币以上,且拥有自主研发、国际领先技术科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位”。根据《试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办法》(中国证券监督管理委员会公告〔2023〕12 号)第七条规定,“前款所称市值,按照试点企业提交纳入试点申请日前一百二十个交易日平均市值计算,汇率按照人民银行公布的申请日前一日中间价计算。”

发行人作为已在境外上市的红筹企业选择的具体上市标准为:“市值 200 亿元人民币以上,且拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力强,同行业竞争中处于相对优势地位。”

公司 2022 年 8 月 8 日向上交所首次提交科创板全套申报文件,截至 2022 年 8 月 7 日,按 2022 年 8 月 5 日的港元对人民币汇率中间价折算,公司前 120 个交易日内平均市值超过 200 亿元人民币,满足招股说明书(申报稿)中明确选择的具体上市标准。

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

### 一、公司基本情况

中文名称	华虹半导体有限公司
英文名称	HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED
已发行股份总数	1,308,147,031 股(截至 2023 年 6 月 30 日)
公司董事	张素心、唐均君、孙国栋、王鼎、叶峻、张祖国、王桂雄、叶龙雷
公司成立日期	2005 年 1 月 21 日
注册地址	香港中环夏德道 12 号美国银行中心 2212 室
主要生产经营地址	中国上海张江高科技园区哈雷路 288 号
邮政编码	201210
联系电话	86-21-50809908
传真	86-21-50809999
公司网址	www.huahongsemi.com
电子信箱	IR@hhgsemi.com
信息披露和投资者关系部门	上市公司工作部
信息披露和投资者关系负责人	Daniel Yu-Cheng Wang(王鼎)
信息披露和投资者关系部门/电话号码	86-21-39829909
经营范围	不适用
主营业务	华虹公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业,也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业,公司立足于先进“特色 IC+功率器件”的战略目标,以发展特色工艺技术为基础,提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业(行业代码:C39)

### 二、控股股东及实际控制人基本情况

#### (一)控股股东

截至 2022 年 12 月 31 日,直接控股股东华虹国际实际直接持有公司 347,605,650 股股份,占公司股份总数的 26.60%。华虹国际基本情况如下:

公司名称	Shanghai Hua Hong International, Inc.
成立日期	2008 年 1 月 2 日
公司编号	114899
注册地/主要生产经营地	The offices of CO Services Cayman Limited., P.O. Box 10008 Airport Willow House, Cricket Square, Cayman Islands
已发行股份数	5 万股
股东构成及控制情况	华虹集团持股 100%
主营业务	投资控股
与公司主营业务的关系	无
项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产(万元)	4,937,543.96
净资产(万元)	2,773,164.46
营业收入(万元)	1,678,571.80
净利润(万元)	273,029.14
审计情况	上述财务数据为合并数据,最近一年的财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计

截至 2022 年 12 月 31 日,华虹集团直接持有华虹国际 100%的股份,华虹集团通过华虹国际实际间接持有发行人 347,605,650 股股份,占发行人股份总数的 26.60%,系发行人的间接控股股东。华虹集团的基本情况如下:

公司名称	上海华虹(集团)有限公司
注册资本	1,125,655.37 万元
实收资本	1,321,423.10 万元(注)
成立日期	1996 年 4 月 9 日
统一社会信用代码	91310000132263312B
注册地/主要生产经营地	中国(上海)自由贸易试验区栖霞路 177 号
经营范围	组织开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品,投资集成电路设计、制造、销售、应用及相关高科技产业,咨询服务,资产管理,自有房屋租赁,停车场(库)经营,【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东构成及控制情况	上海市国有资产监督管理委员会持股 51.59%,上海国际集团有限公司持股 18.36%,上海国盛(集团)有限公司持股 18.36%,仪电集团持股 11.69%
主营业务	投资控股、资产管理
与公司主营业务的关系	无
项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产(万元)	12,229,839.33
净资产(万元)	6,923,026.94
营业收入(万元)	3,160,878.31
净利润(万元)	-4,782.74
审计情况	上述财务数据为合并数据,最近一年财务数据未经审计

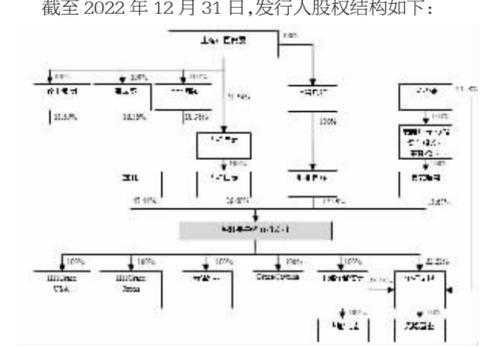
注:实收资本与注册资本的差异为相关国有资本经营预算已到金额,相关增资的工商变更手续尚在办理过程中,本上市公告书所涉华虹集团的股权比例均以工商登记的注册资本口径计算。

#### (二)实际控制人

截至 2022 年 12 月 31 日,上海市国资委直接持有华虹集团 51.59%的股权,系发行人的实际控制人。

(三)本次上市前发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行上市前,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



注:2023 年 3 月,华虹制造完成关于注册资本及股东变更的工商变更手续,变更为上海华虹宏力持股 29.10%、发行人持股 21.90%、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股 29.00%、无锡锡虹国芯投资有限公司持股 20.00%。

### 三、董事、高级管理人员及核心技术人员

#### (一)全体董事、高级管理人员

截至 2022 年 12 月 31 日,发行人现任董事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人权益的情况如下表:

序号	姓名	职务	本届董事任期/高管任职日期	直接持股数量(股)	间接持股数量(股)	合计持股数量(股)	占发行前总股本比例	持有债券情况	限售期限
1	张素心	董事会主席兼执行董事	2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 13 日	-	-	-	-	-	-
2	唐均君	执行董事兼总裁	2022 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 12 日 离任日期:2019 年 5 月起任职	-	-	-	-	-	-
3	孙国栋	非执行董事	2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 13 日	-	-	-	-	-	-
4	王鼎	非执行董事	2022 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 12 日	-	-	-	-	-	-
5	叶峻	非执行董事	2020 年 5 月 14 日至 2023 年 5 月 14 日	-	-	-	-	-	-
6	张祖国	独立非执行董事	2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 13 日	-	-	-	-	-	-
7	王桂雄	独立非执行董事	2022 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 12 日	-	-	-	-	-	-
8	叶龙雷	独立非执行董事	2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 13 日	-	-	-	-	-	-
9	周卫平	执行副总裁	2018 年 2 月至今	-	-	-	-	-	-
10	Daniel Yu-Cheng Wang(王鼎)	执行副总裁、首席财务官兼信息披露和投资者关系代表	2012 年 2 月至今	236,473	-	236,473	0.0181%	-	不适用,所持股票为港股股票
11	Weiran Kong(孔昶然)	执行副总裁	2012 年 2 月至今	169,260	-	169,260	0.0130%	-	不适用,所持股票为港股股票
12	倪立华	执行副总裁	2021 年 11 月至今	12,000	-	12,000	0.0009%	-	不适用,所持股票为港股股票

#### (二)核心技术人员

截至 2022 年 12 月 31 日,公司核心技术人员(孔昶然、倪立华的相关信息已列在上表中)在发行前直接及间接合计持有公司股份的情况如下:

序号	姓名	职务	直接持股数量(股)	间接持股数量(股)	合计持股数量(股)	占发行前总股本比例	持有债券情况	限售期限
1	杨继业	首席技术专家兼总监	-	-	-	-	-	-
2	钱文生	首席技术专家兼总监	9,149	-	9,149	0.0007%	-	不适用,所持股票为港股股票
3	Hualun Chen(陈华伦)	首席技术专家兼总监	-	-	-	-	-	-
4	龚俊之	首席技术专家兼总监	595	-	595	0.0000%	-	不适用,所持股票为港股股票

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司董事、高级管理人员和核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

#### 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划及相关安排

发行人的股权激励计划分为第一期股票期权计划与第二期股票期权计划,已于 2022 年 9 月到期。发行人于 2015 年 9 月、2018 年 12 月、2019 年 3 月及 2019 年 12 月分 4 次共计授出 67,732,000 份期权,每份期权可认购发行人 1 股港股股票。其中,已授予尚未行使的期权 23,438,871 份,占 2022 年 12 月 31 日已发行普通股的 1.79%。发行人的股票期权计划的具体情况如下:

##### (一)第一期股票期权计划

上海市国资委于 2015 年 8 月 14 日出具《关于同意华虹半导体有限公司实施股权激励计划的批复》(沪国资委分配〔2015〕278 号),原则同意《华虹半导体有限公司股权激励计划草案》,并按有关规定提交发行人股东大会审议。

发行人股东特别大会于 2015 年 9 月 1 日作出决议,同意采纳股票期权计划,并授权董事会自计划批准日 7 年内任何时间决定授予股票期权。依据该等股票期权计划,该股票期权计划项下拟授出的所有期权及发行人任何其他股票期权计划项下拟授出的任何期权获行使时可予发行的股票总数,合计不得超过当时的已发行股本总数的 10%;该等股票期权计划项下首次授予的期权数量不超过发行人总股本的 3%。

2015 年 9 月 4 日,发行人向发行人若干员工及当时的

董事授出 30,250,000 份期权,可按行权价 6.912 港元认购合计最多 30,250,000 股股票,本次期权将于 2022 年 9 月 3 日失效。本次期权分三期归属。

##### (二)第二期股票期权计划

上海市国资委于 2019 年 3 月 12 日出具《关于同意华虹半导体有限公司实施股权激励计划(二期)的批复》(沪国资委分配〔2019〕44 号),原则同意《华虹半导体有限公司股权激励计划(二期)方案》,并按有关规定提交发行人股东大会审议。

发行人股东特别大会于 2019 年 3 月 28 日作出决议,同意根据发行人于 2015 年 9 月 1 日采纳的股票期权计划于 2018 年 12 月 24 日授出 34,500,000 份股票期权,并同意于 2019 年 12 月 23 日或前后进一步授出 4,000,000 份股票期权。上述股票期权计划项下历次授予情况如下:

##### 1、2018 年 12 月授予

2018 年 12 月 24 日,发行人向发行人若干员工及当时的董事授出 34,500,000 份期权,可按行权价 15.056 港元认购合计最多 34,500,000 股股票,本次期权将于 2025 年 12 月 23 日失效。其中,对副总裁及以上级别的职员(包括董事),本次期权分四期归属;对其他职员,本次期权分三期归属。

##### 2、2019 年 3 月授予

2019 年 3 月 29 日,发行人向发行人拟任执行董事兼总裁(其委任于 2019 年 5 月 1 日生效)唐均君先生授出 500,000 份期权,可按行权价 18.40 港元认购合计最多 500,000 股股票,于 2026 年 3 月 28 日失效。本次期权分四期归属。

##### 3、2019 年 12 月授予

2019 年 12 月 23 日,发行人向子公司华虹无锡具有重要技术专长及/或担任核心管理职位的 101 名员工授出 2,482,000 份期权,可按行权价 17.952 港元认购合计最多 2,482,000 股股票,于 2026 年 12 月 22 日失效。其中,对副总裁及以上级别的职员,本次期权分四期归属;对其他职员,本次期权分三期归属。

##### 4、2021 年 11 月发行人股票期权计划调整

发行人股东特别大会于 2021 年 11 月 26 日作出决议,鉴于现有股票期权计划限额已多数获使用,为使发行人能够更灵活地向其雇员提供激励及奖励,同意将发行人股票期权计划授出限额调整为 130,047,036 股股票。

截至 2022 年 12 月 31 日,发行人上述已授予的期权中,已行权的期权数量为 30,566,159 份,已授予但尚未行权的期权数量为 23,438,871 份。

上述股权激励计划行权后对应的港股股票在香港联交所流通、交易,将不在 A 股市场流通、交易。

#### 五、本次发行前后的股本结构变动情况

本次初始发行的股票数量 407,750,000 股,不涉及现有股份的转换,为初始发行后股份总数的 23.76%。本次发行前后,公司股本结构如下表所示:

项目	股东名称	股份性质	本次发行前		本次发行后		限售期
			股份数量	持股比例	股份数量	持股比例	
一、A 股限售要求的境外流通股							
境外流通股	华虹国际		347,605,650	26.57%	347,605,650	20.26%	-
	森芯香港		178,705,925	13.66%	178,705,925	10.41%	-
	境外公开发行的股份		160,545,541(注)	12.27%	160,545,541	9.36%	-
	其他流通股		621,289,915	47.49%	621,289,915	36.21%	-
	小计		1,308,147,031	100.00%	1,308,147,031	76.24%	-
二、A 股限售流通股							
有限售条件的流通股	国泰君安证裕投资有限公司		-	-	8,155,000	0.48%	24个月
	海通创新证裕投资有限公司		-	-	8,155,000	0.48%	24个月
	其他参与战略配售的投资者		-	-	187,565,000	10.93%	12个月
	其他流通股		-	-	99,900,748	5.82%	6个月
	小计		-	-	303,775,748	17.70%	-
三、A 股无限售流通股							
无限售条件的流通股	公众股东		-	-	103,974,252	6.06%	-
	境内公开发行的股份		-	-	103,974,252	6.06%	-
合计			1,308,147,031	100.00%	1,715,897,031	100.00%	-

注:1、含联和国际以托管方式持有的 3,084 股股份,下同。

2、本次发行前后股份总数均以 2023 年 6 月 30 日为基准计算,若未来行权导致股份总数发生变化,股份总数将相应调整。

3、无 A 股限售要求的境外流通股为公司已于境外发行的股份,无 A 股普通股,未在中登公司注册,将不在 A 股上市流通、交易。

4、合计数与各部分直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

#### 六、本次发行后持 A 股数量前十名股东

本次发行后持公司 A 股数量前十名股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限(自上市之日起)
1	华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	48,334,249	11.85%	12个月
2	国新投资有限公司	23,076,923	5.66%	12个月
3	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	23,076,923	5.66%	12个月
4	中保投资有限公司-中国保险投资基金(有限合伙)	13,461,538	3.30%	12个月
5	上海国际集团资产管理有限公司	9,615,384	2.36%	12个月
6	海通创新证裕投资有限公司	8,155,000	2.00%	24个月
7	国泰君安证裕投资有限公司	8,155,000	2.00%	24个月
8	无锡市创新投资集团有限公司	7,692,307	1.89%	12个月
9	上海科技创业投资(集团)有限公司	4,807,692	1.18%	12个月
10	上海浦东科创集团有限公司	4,807,692	1.18%	12个月
	合计	151,182,708	37.08%	7

注:1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注 2:上述持股比例为前十名股东持有本次发行 A 股股份的相应比例。

#### 七、本次发行战略配售情况

公司本次公开发行股票的数量为 40,775.0000 万股普通股,占公司发行后总股本的比例为 23.76%。其中,初始战略配售发行数量为 20,387.5000 万股,占本次发行数量的 50.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 20,387.5000 万股,与本次发行总数量 50.00%,因最终战略配售股数与初始战略配售股数数量相同,本次发行战略配售数量未向下发行进行回拨。

##### (一)本次战略配售的总体安排

本次发行的战略配售由联席保荐人相关子公司跟投和其他参与战略配售的投资者组成。跟投机构为国泰君安另类投资公司证裕投资、海通证券另类投资公司海通创投;其他参与战略配售的投资者类型:与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业和具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。本次战略配售最终结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次初始发行数量的比例	获配金额(元)	限售期(月)
1	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	具有长期投资意愿的大型企业或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	48,334,249	11.85%	2,513,380,948.00	12
2	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司		23,076,923	5.66%	1,199,999,996.00	12
3	中国保险投资基金(有限合伙)		13,461,538	3.30%	689,999,976.00	12
4	中国互互联网投资基金(有限合伙)		3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
5	浙江制造基金合伙企业(有限合伙)		3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
6	国新投资有限公司		23,076,923	5.66%	1,199,999,996.00	12
7	上海国际集团资产管理有限公司		9,615,384	2.36%	489,999,968.00	12
8	无锡市创新投资集团有限公司		7,692,307	1.89%	389,999,964.00	12
9	上海科技创业投资(集团)有限公司		4,807,692	1.18%	249,999,984.00	12
10	上海浦东科创集团有限公司		4,807,692	1.18%	249,999,984.00	12
11	建投投资有限责任公司		3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
12	上海国盛(集团)有限公司		3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
13	上海强资本管理有限公司		3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
14	无锡产业发展集团有限公司		3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
15	成都高新投资集团有限公司		3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
16	重庆渝资本运营集团有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12
17	阿布达比投资		3,846,153	0.94%	199,999,956.00	12